

公司代码：688037

公司简称：芯源微



沈阳芯源微电子设备股份有限公司  
2023 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，截至本公告日，公司总股本为137,887,011股，扣除回购专用证券账户中股份数60,470股后的剩余股份总数为137,826,541股，以此为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。

该利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	芯源微	688037	/

#### 公司存托凭证简况

适用 不适用

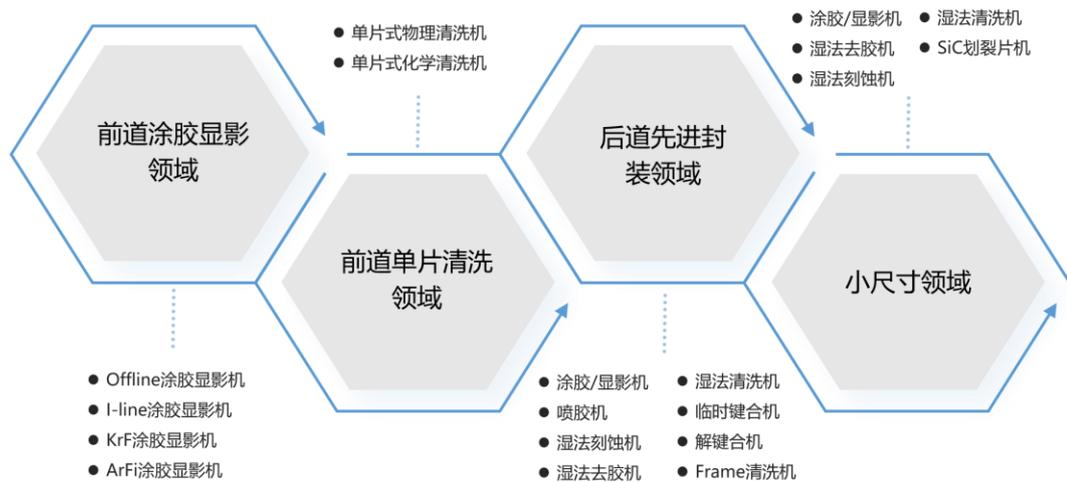
#### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	刘书杰	李辰、宗健腾
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号	辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号
电话	024-86688037	024-86688037
电子信箱	688037@kingsemi.com	688037@kingsemi.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一） 主要业务、主要产品或服务情况

公司成立于2002年，主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备。经过20余年的技术发展，公司在巩固传统优势领域的基础上不断丰富产品布局，目前已形成了前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备、化合物等小尺寸设备四大业务板块，产品已完整覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域。



## 1、新签订单情况

受全球经济疲软、国际贸易不确定性增加、终端市场需求不振等多重因素影响，2023 年国内前道晶圆厂资本开支进入过渡性放缓阶段，后道先进封装领域行业景气度周期下行。从半导体行业历史发展规律来看，半导体行业兼具周期性和成长性，阶段性放缓不会改变长期向好的趋势。SEMI 在 2024 年 3 月发布的《300mm 晶圆厂 2027 年展望报告》中指出，未来几年下游市场对电子产品的成长需求以及人工智能创新带来的应用浪潮将持续引领晶圆厂进行产能扩张，全球前道 300mm 晶圆厂设备支出预估将持续增长，2025 年预计将增长 20%至 1165 亿美元，2027 年将达到创纪录的 1370 亿美元。

报告期内，公司继续加大研发投入，产品竞争力得到进一步增强，同时公司积极开拓新客户，取得了良好进展。在新签订单方面，公司前道涂胶显影设备签单同比保持了良好的增长速度，国内市场份额进一步提升，所处细分赛道稀缺性得到市场进一步认可；前道清洗设备签单较为稳健，其中物理清洗机继续保持行业龙头地位，化学清洗机新品在重点客户实现有序突破，有望成为公司新的业绩增长点；后道先进封装及小尺寸签单则受下游市场景气度影响阶段性承压。2023 年，公司全年新签订单与 2022 年基本持平，截至报告期末，公司在手订单约为 22 亿元（含税），可以对 2024 年业绩起到较好的支撑。

## 2、产品销售情况

### （1）前道涂胶显影设备

全球前道涂胶显影设备市场长期被日本厂商高度垄断，目前国产化率仍然较低，作为半导体产线上唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备，近年来，前道涂胶显影设备的国产化替代得到了下游客户的高度重视和大力支持。公司经过长期的研发、多轮次验证及量产应用，目前已成功推出了包括 offline、I-line、KrF 及 ArF 浸没式在内的多种型号产品，成功在下游客户端抢占一席

之地。报告期内，在国内前道晶圆厂扩产节奏有所放缓的行业背景下，公司前道涂胶显影设备新签订单依然保持了良好的增长速度，部分型号设备整体工艺水平已能够对标国际主流机台，客户认可度不断提升，批量销售规模持续增长。

报告期内，公司 ArF 浸没式高产能涂胶显影设备在成熟化、标准化等方面也取得良好进展，截至报告期末，公司浸没式机台已获得国内 5 家重要客户订单。此外，公司在高端 NTD 负显影、SOC 涂布等新机台销售方面也取得了良好进展，进一步拓展了公司涂胶显影设备的工艺应用场景和市场空间。

### （2）前道清洗设备

公司前道物理清洗机自 2018 年发布以来，凭借其高产能、高颗粒去除能力、高性价比等优势受到下游客户的广泛认可，产品迅速打破国外垄断并确立了市场领先优势，目前已广泛应用于中芯国际、上海华力、青岛芯恩、广州粤芯、上海积塔、厦门士兰等一线大厂，已成为国内逻辑、功率器件客户主力量产机型。报告期内，公司新一代高产能物理清洗机已发往国内重要存储客户开展验证，机台应用新一代高产能架构，可满足存储客户对产能的更高指标要求，未来有望在存储领域打开新的增量市场空间。

此外，公司战略性新产品前道化学清洗机的研发与产业化也取得实质性突破，目前已获得国内重要客户的验证性订单，未来有望成长为公司新的业绩增长点。该机台的推出，标志着公司从前道物理清洗领域成功跨入到技术含量更高、市场空间更大的前道化学清洗领域，将公司前道产品（涂胶显影+清洗）的国内市场空间由原来的百亿元级别大幅提升至两百亿元级别，进一步完善了公司在前道领域的战略布局。

### （3）后道先进封装设备

公司后道先进封装用涂胶显影设备、单片式湿法设备已连续多年作为主流机型批量应用于台积电、盛合晶微、长电科技、华天科技、通富微电、珠海天成等海内外一线大厂，已经成为众多知名客户的首选品牌，机台部分技术指标已达到国际领先水平，具有较强的全球竞争力，获得多家海外客户的持续认可。报告期内，公司向多家海外客户实现产品销售。

此外，为积极响应国家支持 Chiplet 产业大发展的号召，公司基于在先进封装领域多年的技术积累和客户储备，积极围绕头部客户需求开展 2.5D/3D 先进封装相关新品的研发及国产化替代，已快速切入到新兴的 Chiplet 大市场，目前已成功推出了包括临时键合、解键合、Frame 清洗等在内的多款新产品，并实现了良好的签单表现。未来，公司将继续围绕头部客户需求，持续开发其他 Chiplet 新品类，不断丰富公司在先进封装领域的产品布局。

#### （4）化合物等小尺寸设备

公司化合物等小尺寸设备近年来已作为主流机型批量应用于三安集成、华灿光电、乾照光电、北京赛微、江西兆驰等国内一线大厂，已经成为客户端的主力量产设备。报告期内，受下游市场景气度影响，该细分领域销售额有所下滑。

### 3、新产品开发和商业化情况

#### （1）前道化学清洗设备

公司战略性新产品前道化学清洗机 KS-CM300/200 于 2024 年 3 月正式公开发布，机台具有高工艺覆盖性、高稳定性、高洁净度、高产能等多项核心优势，并于 2023 年第四季度获得了国内重要客户的验证性订单。目前，公司已与国内其他多家重要客户达成合作意向，部分客户已进入配置确认和商务流程阶段。作为公司的战略性新产品，后续公司将继续加大研发和推广力度，快速推进化学清洗机的商业化进程。

#### 前道化学清洗机 KS-CM300/200



①高工艺覆盖性：设备适用于薄膜前后清洗、干法蚀刻后清洗、离子注入灰化后清洗、CMP 后清洗等多种清洗工艺，能够适配高温 SPM 工艺，整体工艺覆盖率达到 80%以上。

②高稳定性：机台 UP Time 达到高指标要求，刻蚀一致性随机抽取 100 组稳定在 2%以内，可以满足客户的高稳定性需求。

③高洁净度：机台借鉴了公司前道涂胶显影和前道物理清洗的成熟技术，通过气体流场仿真优化，确保机台内部微环境均匀稳定，同时搭载了独立研发的新一代高清洗效率低损伤射流喷嘴，通过 26nm particle 测试，达到先进制程所需工艺水平。

④高产能：通过移植前道涂胶显影设备多层堆叠的技术优势，同时搭载公司自研的高速机械手，机台 16 腔高产能架构可以实现清洗效率的大幅提升，整体工艺产能够对标国际主流机台，达到国际先进水平。

相比于前道涂胶显影设备，前道清洗类设备标准化程度相对较高，验证周期较短，通过验证后有望快速提升市场份额。公司于 2018 年发布前道物理清洗设备后，在两年的时间内迅速成为了客户端主力量产机型。公司将借助前道物理清洗设备的成功经验，力争在前道化学清洗赛道实现跨越式发展，未来与前道涂胶显影设备一道形成两大主打优势产品，为公司长期发展提供稳定的业绩增长点。

## （2）临时键合、解键合设备

在 Chiplet 技术中，需要将器件晶圆进行减薄处理，由于超薄晶圆具有高柔性、高脆性、易翘曲、易起伏等特点，在减薄过程中极易产生碎裂、变形等缺陷，良品率极低。为了降低减薄工艺中的碎片率，提高芯片制造的良率、加工精度和封装精度，通常采用临时键合及解键合技术，在背面减薄前，采用临时键合的方式将晶圆转移到载片上为其提供强度支撑，完成背面减薄及其他背面工艺后进行解键合。



临时键合机 KS-C300-TB



解键合机 KS-S300-DBL

目前，国内高精度临时键合设备市场长期被海外厂商高度垄断，针对 Chiplet 技术解决方案，公司提前布局自主研发的全自动临时键合及解键合机，可应用于 InFO、CoWoS、HBM 等 2.5D、3D 技术路线产品，兼容国内外主流胶材工艺，能够适配 60 微米及以上超大膜厚涂胶需求，可实现高对准精度、高真空度环境、高温高压键合工艺，键合后产品 TTV 及翘曲度表现优异，对应开发的机械、激光解键合技术，可覆盖不同客户产品及工艺需求，为客户提供稳定高效的临时键合、解键合全流程解决方案。

2021 年，公司获得国内重要存储客户支持，开始系统性研发临时键合、解键合设备，目前公司临时键合机、解键合机整体技术已达到国际先进水平，陆续获得国内多家头部客户订单，进入小批量销售阶段。此外，公司在 2.5D/3D 先进封装领域布局的新产品 Frame 清洗设备，目前也已

进入小批量销售阶段。

### （3）全自动 SiC 划片裂片一体机

2024 年 3 月，公司发布了全自动 SiC 划裂片一体机 KS-S200-2H1L，该款机台由公司日本子公司与合作伙伴联合研发，借助独有的 SnB 划裂片技术，可以有效解决传统砂轮式切割方法所面临的崩边大、切割损失多、生产效率低、切割水处理等问题。机台对 SiC 晶圆切割速度约为 100mm/s，相比传统划片机切割速度大幅提升，产能效率得到大幅提升，同时拥有零切口损失、断面平整、崩边裂痕少等优势，可助力客户在同等尺寸晶圆下切出更多晶粒，同时有效提升客户产品良率。



全自动 SiC 划裂片一体机 KS-S200-2H1L

该产品的推出将进一步丰富公司在小尺寸领域的产品布局，助力公司从现有的涂胶显影、单片湿法等领域拓展至划片领域，为客户提供更丰富优质的产品选择，将进一步提升公司在小尺寸领域的综合竞争优势。

## 4、人才团队建设情况

人才是企业发展的基石，公司高度重视优秀人才的引进、培养和研发团队的建设。报告期内，公司持续引进外部优秀人才，公司员工人数由 880 人增加至 1118 人。公司拥有高水平的研发团队，研发人员中硕士研究生及以上学历占比超过 50%。团队激励方面，公司在 2020、2021 年两期限制性股票激励计划的基础上，于 2023 年 8 月发布了新一期限制性股票激励计划，以 50 元/股的授予价格向 160 名激励对象授予 126 万股限制性股票，授予对象以核心技术骨干为主，同时明确了公司和员工业绩考核指标，有助于调动核心员工积极性，有利于公司长期稳定可持续发展。

## 5、厂区及子公司布局情况

公司上海临港厂区于 2024 年 3 月正式投产，公司目前已拥有沈阳飞云路、沈阳彩云路、上海临港三大生产基地，产能储备充沛。此外，为更好地开拓外部资源，公司分别在日本、广州、沈

阳设立了三家子公司，其中，日本子公司成立于 2022 年 8 月，主要开展境外核心供方资源开拓、高端人才引进以及新品开发等；广州子公司成立于 2023 年 9 月，主要开展光刻胶泵等核心关键零部件研发及产业化；沈阳子公司成立于 2024 年 1 月，未来将主要开展 2.5D、3D 等高端封装新品的研发及产业化。

## （二） 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

半导体被称为制造业皇冠上的明珠，半导体产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。作为“工业粮食”，半导体芯片被广泛地应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子、物联网等产业，是绝大多数电子设备的核心组成部分。根据国际货币基金组织测算，每 1 美元半导体芯片的产值可带动相关电子信息产业 10 美元产值，并带来 100 美元的 GDP，这种 100 倍价值链的放大效应奠定了芯片行业在国民经济中的重要地位。

为推动半导体产业发展，增强产业创新能力和国际竞争力，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国先后出台《科技部重点支持集成电路重点专项》、《集成电路产业“十三五”发展规划》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》、《“十四五”国家信息化规划》等鼓励和支持半导体设备产业发展的政策，为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。2022 年 11 月，辽宁省政府发布了《辽宁省培育壮大集成电路装备产业集群若干措施》，在企业销售规模奖励、投资建设项目、新产品销售奖励、研发费用补助、人才引进激励等多个维度大力支持辽宁省集成电路装备产业发展。

从全球半导体设备行业来看，随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及人工智能、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片带来的产能扩张需求，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。SEMI 于 2024 年 3 月发布的《300mm 晶圆厂 2027 年展望报告》指出，全球前道 300mm 晶圆厂设备支出预估在 2025 年首次突破 1000 亿美元，到 2027 年将达到 1370 亿美元的历史新高，SEMI 表示，下游市场对电子产品的成长需求以及人工智能创新带来的应用浪潮将持续引领晶圆厂进行产能扩张，预估未来几年内前道 300mm 晶圆厂设备支出将呈现大幅成长。

从我国半导体设备行业来看，集成电路产业国际产能不断向我国大陆地区转移，据 SEMI 统计，2016-2021 年，我国大陆的半导体设备市场规模从 64.60 亿美元增长至 296 亿美元，近五年来年

均复合增长率达到 35.58%，远高于全球市场增速。近两年国内半导体行业受国际形势等多重因素交叠影响，国内晶圆厂扩产进入过渡性放缓阶段，但中长期发展趋势仍然良好。SEMI 发布的《300mm 晶圆 2027 年展望报告》显示，在政府激励措施和芯片国产化政策的推动下，中国未来四年将保持每年 300 亿美元以上的投资规模，继续引领全球晶圆厂设备支出。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国科天等为代表的国际知名企业占据了全球半导体设备市场的主要份额。

公司是国内涂胶显影、单片式湿法设备龙头企业，近年来持续加大研发投入，推出了前道单片式化学清洗设备、临时键合解键合设备、SiC 划裂片设备等多款新产品，目前已形成了前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备、化合物等小尺寸设备四大业务板块，产品已完整覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### (1) 光刻机向着更高产能、更高精度方向持续进步

近年来，全球光刻机龙头厂商 ASML 在光源光罩系统、软件及算法等多方面陆续取得技术突破与进步，主要产品 DUV 光刻机在产能、精度指标上持续提升。在产能效率方面，其 KrF 系列目前主流光刻机 XT860 产能约 240-260WPH，新款 NXT870 目前已实现量产产能 330WPH，下一代产品 NXT870B 产能将进一步大幅提升，对与之配套工作的涂胶显影设备产能提升提出较高要求；在套刻精度方面，ArFi 系列目前主流光刻机 NXT1980Di Overlay 可达到 2.5nm，新款 NXT2100i Overlay 可达到 1.3nm，下一代产品 NXT2150i 套刻精度将继续提升。

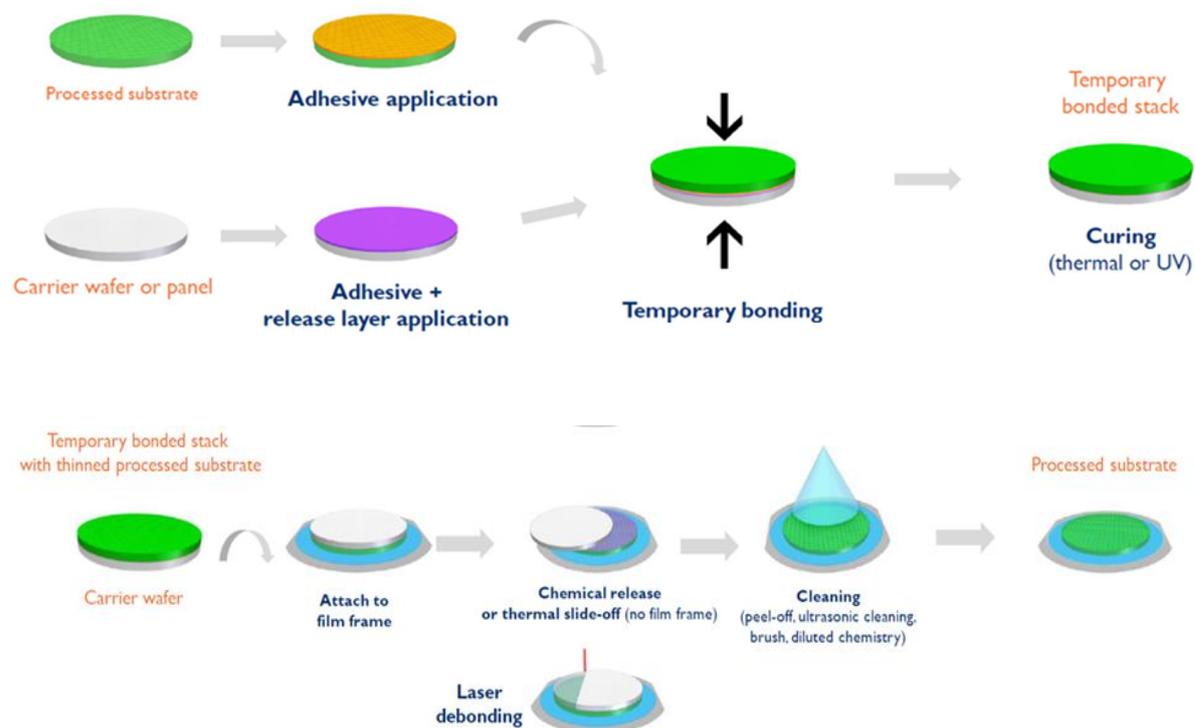
涂胶显影机作为半导体产线上唯一与光刻机联机作业的重要设备，技术发展方向主要依据主流光刻机的发展路线。目前，公司第三代架构浸没式高产能涂胶显影机在复杂光刻工艺下已实现和全球主流光刻机联机量产工作。随着光刻机产能的不断提升，公司已布局新一代更高产能的涂胶显影机架构，新一代机台将应用更高工艺精度的超薄成膜、超细线宽均一性、精细缺陷控制等技术。未来，公司将继续锚定全球主流光刻技术发展进程，持续提升涂胶显影设备各项核心指标，加速高端涂胶显影设备的国产化替代进程。

### (2) 2.5D、3D 先进封装技术高速发展

在半导体飞速发展的五十年里，“摩尔定律”作为信息技术进步的重要驱动力，一直推动着芯片器件不断向小型化的方向发展。然而，随着晶体管特征尺寸日益接近物理极限，量子效应和短沟道效应导致芯片制造存在工艺误差和加工缺陷，芯片制造成本成倍增加，进而限制了晶体管的进一步缩小，单纯依靠尺寸微缩的方法已经难以满足未来集成电路产业的发展需求。在摩尔定律逐渐放缓的情况下，Chiplet 技术已成为持续提高集成度和芯片算力的重要途径之一。

在 Chiplet 技术中，需要将晶圆进行减薄处理，但超薄晶圆具有高柔性、高脆性、易翘曲、易起伏等特点，在减薄过程中极易产生碎裂、变形等缺陷，良品率极低。为了降低减薄工艺中的碎片率，提高芯片制造的良率、加工精度和封装精度，通常采用临时键合及解键合技术，在背面减薄前，采用临时键合的方式将晶圆转移到载片上为其提供强度支撑，完成背面减薄及其他背面工艺后进行解键合。

临时键合、解键合工艺流程图



公司提前布局自主研发的全自动临时键合及解键合机，可应用于 InFO、CoWoS、HBM 等 2.5D、3D 技术路线产品，兼容国内外主流胶材工艺，能够适配 60 微米及以上超大膜厚涂胶需求，可实现高对准精度、高真空度环境、高温高压键合工艺，键合后产品 TTV 及翘曲度表现优异，对应开发的机械、激光解键合技术，可覆盖不同客户产品及工艺需求，为客户提供稳定高效的临时键合、解键合全流程解决方案。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	4,301,555,628.29	3,496,333,727.06	23.03	1,960,914,071.65
归属于上市公司股东的净资产	2,380,440,281.77	2,106,541,950.00	13.00	897,248,075.62
营业收入	1,716,969,907.58	1,384,867,131.46	23.98	828,672,512.29
归属于上市公司股东的净利润	250,626,202.20	200,160,932.53	25.21	77,349,494.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,165,171.65	137,247,261.68	36.37	63,838,961.51
经营活动产生的现金流量净额	-562,876,699.27	192,963,939.50	-391.70	-218,325,429.94
加权平均净资产收益率(%)	11.24	13.36	减少2.12个百分点	9.20
基本每股收益(元/股)	1.82	2.27	-19.82	0.92
稀释每股收益(元/股)	1.82	2.27	-19.82	0.92
研发投入占营业收入的比例(%)			增加0.53个百分点	

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	288,217,307.17	407,384,638.68	510,879,088.06	510,488,873.67
归属于上市公司股东的净利润	65,977,387.50	69,698,716.82	84,551,975.00	30,398,122.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,144,149.76	46,603,309.06	78,003,421.03	5,414,291.80

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
经营活动产生的现金流量净额	-173,408,436.42	-184,023,787.83	-232,174,031.50	26,729,556.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								13,692
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								13,671
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								0
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 条件 股份 数量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
沈阳先进制造技术 产业有限公司	5,209,373	15,909,156	11.54	0		无	0	境内 非国 有法 人
辽宁科发实业有限 公司	5,667,754	14,700,574	10.66	0		无	0	国有 法人
沈阳中科天盛自动 化技术有限公司	1,155,000	11,655,000	8.45	0		无	0	国有 法人

香港中央结算有限公司		3,154,229	2.29	0		无	0	其他
中国科技产业投资管理有限公司	-741,600	2,523,400	1.83	0		无	0	国有法人
宗润福	269,818	2,435,273	1.77	0		无	0	境内自然人
周冰冰	480,861	2,426,866	1.76	0		无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—东方人工智能主题混合型证券投资基金	2,255,109	2,292,533	1.66	0		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	1,960,433	2,281,397	1.65	0		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—银华集成电路混合型证券投资基金	1,626,038	2,206,077	1.60	0		无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

#### 存托凭证持有人情况

适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

## 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。报告期内，公司实现营业收入 171,696.99 万元，较上年同期增长 23.98%；归属于上市公司股东的净利润 25,062.62 万元，较上年同期增长 25.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,716.52 万元，较上年同期增长 36.37%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用